

Uso de modelos e imágenes en 3D

Response ID:286 Data

1. Código de país

1. Please enter the two-letter country code corresponding to your Office or Organization.

Don't know your country code? [Please click here.](#)

US

Please enter your email address so we can contact you if we have questions about your response.

████████████████████

2. Preguntas

Esta encuesta fue aprobada por el Comité de Normas Técnicas de la OMPI (CWS) en su séptima sesión con miras a recabar información sobre las prácticas y necesidades de las OPI y los usuarios (solicitantes) acerca del uso de objetos en 3D.

[PROYECTO DE CUESTIONARIO SOBRE EL USO DE MODELOS E IMÁGENES EN 3D EN LOS DATOS Y DOCUMENTACIÓN DE PI](#)

Glosario

3D: fichero electrónico creado por un software especializado para representar matemáticamente la superficie de un objeto en tres dimensiones.

Imágenes en 3D - Imágenes que representan objetos visualizados en tres dimensiones (longitud, profundidad, altura), por ejemplo, fotos en 3D, estereoscopía, etc.

3DS: formato de fichero utilizado por el software de modelado, animación y renderizado 3D Autodesk 3ds Max.

DWF: Design Web Format (formato de diseño web).

DWG: formato de fichero frecuentemente utilizado para los dibujos CAD.

IGES: Initial Graphics Exchange Specification.

OBJ: formato abierto de fichero de vértices geométricos utilizado para la impresión en CAD y 3D.

Imagen de trama: imagen que se compone de un mapa de puntos (píxeles), denominado mapa de bits. Entre los formatos de fichero más habituales para las imágenes de trama están JPEG, TIFF, PNG y BMP.

STL: Standard Tessellation Language: formato de fichero propio del software CAD de estereolitografía creado por 3D Systems.

STEP: Standard for the Exchange of Product (norma para el intercambio de datos de modelos de productos): norma ISO abierta que puede representar objetos en 3D en el ámbito del diseño asistido por computadora (CAD) e información relacionada.

Gráficos vectoriales: fichero de imagen que se obtiene a partir de formas constituidas por fórmulas matemáticas y coordenadas en un plano 2D. A diferencia de las imágenes de trama, los gráficos vectoriales pueden dimensionarse infinitamente sin degradación de la calidad.

X3D: sucesor del VRML, formato XML abierto de normas ISO.

Parte 1. Objetos de PI y fases de su ciclo de vida

2. 1.1 ¿Utiliza actualmente su oficina modelos o imágenes en 3D para objetos de PI? De ser así, ¿para qué objetos de PI?

Marcas

Otros (especifique cuáles): Trademarks Office currently accepts 3D images and stores as 2D image. The Description of Mark references the mark as 3D. Design Patents- Other (please specify): We have interpreted the definitions in this survey to mean that "3D images" encompasses mathematical models that can be virtually manipulated in three dimensions, such as CAD drawings. For design patent applications, USPTO only accepts static 2D image files which may convey 3D features through the use of, for example, shading and perspective.

3. 1.2 ¿Considera su oficina la posibilidad de utilizar modelos o imágenes en 3D para objetos de PI en el futuro? De ser así, ¿para qué objetos de PI?:

Otros (especifique cuáles): Design Patents- Other (please specify): The USPTO's existing plans for 3D models and 3D images include permitting exhibition or demonstration of such by applicants during examiner interviews, per MPEP 713.08. Future plans include studying 3D models and 3D images as they pertain to patent applications. Trademarks Office may consider using 3D images for IP objects in the future. The Office has not determined which IP object to be considered 3D images.

4. 1.3. ¿En qué fases del ciclo de vida de los objetos de PI acepta o emplea actualmente su oficina modelos en 3D?

	Presentación de solicitudes	Examen	Almacenamiento	Búsqueda	Publicación	Intercambio de datos	Otras (especifique cuáles en comentario)
Marcas							
Dibujos y modelos industriales							
Patentes en química como campo de la tecnología (p.ej. estructuras químicas, estructuras biológicas)							
Patentes en otros campos de la tecnología (por ejemplo, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, etc.)							
Topología de circuito integrado							

Comentario: Under the interpretation that "accept/implement" means "formally enter into an application file wrapper", USPTO does not accept or implement 3D models at any of the listed stages for design patent applications. Integrated Circuit Topology (mask works) is covered by the Semiconductor Chip Protection Act ("SCPA") of 1984, 17 U.S.C. §§ 901-14 . TM is only accepting 2D image. However, the Description of Mark can describe the 3D image of the Mark.

5. 1.4. ¿Realiza su Oficina transformaciones de imágenes? En caso afirmativo, ¿para qué objetos y en qué fases?

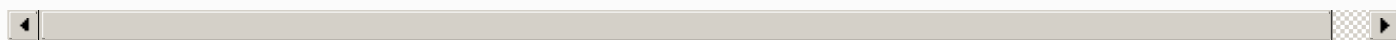
	Presentación de solicitudes	Examen	Almacenamiento	Búsqueda	Publicación	Intercambio de datos	Otras (especifique cuáles en comentario)
Marcas							
Dibujos y modelos industriales							
Patentes en química como campo de la tecnología (p.ej. estructuras químicas, estructuras biológicas)							
Patentes en otros campos de la tecnología (por ejemplo, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, etc.)							
Integrated circuit topology							

Comentario: USPTO accepts PDF image files, which are transformed to TIFF files and used in examination, search, publication and data exchange systems. The originally submitted PDF image file is also available for examiners and the public. USPTO receives JPEG image files for Hague applications, which are transformed to PDF files. These files are used in examination. The files are transformed to TIFF images for search, publication and data exchange. The originally submitted JPEG and PDF image files are also available for examiners and the public to view. Trademarks does not currently conduct any transformations of image files.

6. 1.5. ¿En qué fases del ciclo de vida de los objetos de PI considera su oficina la posibilidad de aceptar o emplear modelos en 3D en el futuro?

	Presentación de solicitudes	Examen	Almacenamiento	Búsqueda	Publicación	Intercambio de datos	No lo sé con seguridad	Otras (especifique cuáles en comentario)
Marcas								
Dibujos y modelos industriales								
Patentes en química como campo de la tecnología (p.ej. estructuras químicas, estructuras biológicas)								
Patentes en otros campos de la tecnología (por ejemplo, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, etc.)								
Topología de circuito integrado								

Comentario: USPTO continues to study 3D models and 3D images in reference to patent applications and monitor progress in this area. At this point, TM is not sure when TM will start accepting 3D images and in what format. TM will continue allowing applicants to describe the 3D mark.



Parte 2. Prácticas actuales y planes de futuro

7. 2.1. Describa las prácticas actuales/planes futuros de uso de modelos e imágenes en 3D en su oficina

USPTO's existing plans for 3D models and 3D images include permitting exhibition or demonstration of such by applicants during examiner interviews, per MPEP 713.08. Future plans include studying 3D models and 3D images as they pertain to patent applications. The current practice at TM for 3D image is required to describe the 3D image in the Description of Mark field. Submit 2D image.

Parte 3. Normativa

8. 3.1. ¿Qué leyes y normativas en materia de modelos e imágenes en 3D se aplican en su territorio?

37 CFR 1.91- 37 CFR 1.91 Models or exhibits not generally admitted as part of application or patent.
MPEP 608.03(a)- 608.03(a) Handling of Models, Exhibits, and Specimens [R-07.2015]

Parte 4. Formatos y herramientas técnicas

9. 4.1. ¿Qué formatos de modelos o imágenes en 3D utiliza su oficina en la actualidad? ¿Utiliza su oficina los mismos o diferentes formatos según las fases del ciclo de vida: presentación, examen, publicación, etcétera?

N/A - For design patent applications, USPTO only accepts static 2D image files

10. 4.2. ¿Qué formatos de modelos o imágenes en 3D piensa utilizar su oficina en el futuro? ¿Considera su oficina la posibilidad de utilizar los mismos o diferentes formatos para diferentes etapas del ciclo de vida: presentación, examen, publicación, etcétera?

USPTO has not determined the format. Hopefully, 3D model and 3D image standard can provide a format that can be used across the board.

11. 4.3. Comuníquennos sus sugerencias y propuestas sobre los formatos y las razones por las que consideran que son importantes (lista de formatos a tener en cuenta), excepto los mencionados en los puntos 6.1 y 6.2

N/A

12. 4.4. ¿Qué herramientas técnicas utiliza actualmente su oficina para manejar modelos en 3D (por ejemplo, visualizadores, convertidores, etc.)? ¿Están estas herramientas estándar a la venta en el mercado? ¿Ha pensado en utilizar alguna herramienta especial desarrollada para su Oficina o por su Oficina?

N/A

13. 4.5. ¿Qué herramientas técnicas piensa utilizar en el futuro su oficina para manejar modelos en 3D (por ejemplo, visualizadores, convertidores, etc.)? ¿Están estas herramientas estándar a la venta en el mercado? ¿Ha pensado en utilizar alguna herramienta especial desarrollada para su Oficina o por su Oficina?

N/A

14. 4.6. Comuníquennos sus sugerencias y propuestas sobre las herramientas y las razones por las que consideran que son importantes (lista de herramientas a tener en cuenta)

N/A

Parte 5. Requisitos específicos y limitaciones

15. 5.1. Indíquennos sus preferencias en lo referente a los ficheros, a saber, si deben ser iguales o diferentes en función de los objetos y fases (es decir, limitaciones y restricciones para ficheros en 3D, tamaño (Mb) y formato del modelo en 3D para almacenar, procesar y transmitir, etcétera)

N/A

16. 5.2. En su opinión, ¿cuáles deberían ser los principales requisitos a la hora de elegir los formatos de fichero en 3D (código abierto, adopción generalizada)?

For TM, In my opinion, the main requirement shall be adaptable and widely supportable

17. 5.3. En su opinión, ¿cuáles deberían ser los principales requisitos a la hora de elegir herramientas para manejar ficheros en 3D?

For TM, In my opinion, the requirement for tool shall be free for viewing, backward compatible, open source for editing.

Part 6. Expectations concerning the use of 3D

18. 6.1. ¿Qué ventajas o inconvenientes concretos espera de los modelos en 3D en relación con la búsqueda, por ejemplo, la búsqueda del estado de la técnica?

N/A

19. 6.2. ¿Espera que los solicitantes proporcionen modelos en 3D que satisfagan las normas definidas?

N/A

Parte 7. Comentarios adicionales

20. 7.1. ¿ Tiene algún otro comentario?

None

3. Revisión

You have reached the end of the survey questions. Your answers have been saved.

If you or your colleagues wish to revise your answers later, you can use the link emailed to you with the Save and Continue option in the top right of this page. The Review or Back button below will return you to your answers.

When you are ready to submit your final answers, click the Submit button below. You will no longer be able to edit your responses after clicking Submit.

Puede descargar una copia de sus respuestas:

4. Gracias!

Gracias por tomar la encuesta.